ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Отмывочная жидкость «ДиКлин»

Производитель:

РТМ

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Назначение	Отмывочные жидкости

Описание

Жидкость «ДиКлин» предназначена для отмывки печатных плат и собранных электронных модулей от всевозможных загрязнений, возникающих в процессе сборки, позволяет производить высококачественную отмывку всех существующих на рынке паяльных паст и флюсов.

ДиКлин — отмывочная жидкость для полуводной отмывки, она удаляет остатки флюсов, паст, консервационных смазок, следы от пальцев и т. п. Жидкость имеет длительный срок жизни в ванне, отличную насыщаемость и высокую отмывочную способность. Она прекрасно растворяет как полярные, так и неполярные загрязнения. Жидкость полностью смывается водой. После ополаскивания поверхность отмытого изделия не имеет разводов.

Отличительными особенностями новой отмывочной жидкости российского производства являются:

- Экономичность — длительное время жизни раствора в ванне, высокая поглощающая способность.
- Универсальность — отмывает печатные платы, трафареты и оборудование.
- Высокая эффективность — растворяет все виды остатков флюсов.
- Отличное качество отмывки, без разводов.

Основные физические свойства

Плотность при 20 °C	1,05 г/см3
Диапазон кипения	170 - 179 °C
Точка вспышки	83 °C
pH (10 гр./л. H2O)	10
Температура отмывки	40 - 50 °C
Растворимость в воде	полная
Концентрация раствора	100%
Кинематическая вязкость 20 °C	7,0 мПа·с
Срок годности	2 года

Упаковка	Полиэтиленовые канистры 1 л, 5 л, 10 л, 20 л, бочка 200 л

Рекомендации по применению

Жидкость поставляется готовой к работе и не требует дополнительной подготовки. ДиКлин разработан для следующих процессов отмывки:

- струйная отмывка в объеме моющего раствора
- ультразвуковая отмывка
- ручная отмывка

Отмывка осуществляется погружением изделия в ванну с жидкостью, нагретой до температуры 45 - 60°С. Отмывка продолжается 5-10 минут, далее промываются деионизованной водой, а затем сушатся теплым воздухом для удаления воды из-под компонентов, переходных отверстий и т.д.